

## Plaskon NXG-1LAR

Epoxy; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

### Описание материалов:

This material is an epoxy molding compound for high temperature, lead-free reflow in low alpha applications. It is designed to withstand more demanding requirements in moisture performance, occasioned by the higher IR reflow temperatures required for processing lead-free packages. It is a highly filled, hybrid resin developed to pass JEDEC Level 2A at 260°C IR reflow temperature. It is a "green" compound with no halogens and a lower Tg than multifunctional materials.

Главная Информация			
Характеристики	Полупроводникового Низкая гигроскопичность Ускоренная Настройка Хорошая производительность формования Без галогенов		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Литье из смолы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.00	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			ASTM D790
22°C	2.45	MPa	ASTM D790
260°C	0.0686	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
22°C	0.0123	MPa	ASTM D790
260°C	8.14E-4	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	150	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	9.0E-6	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.70	W/m/K	ASTM C177
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0	UL 94	

### Дополнительная информация

Recommended Storage Temperature: <5°C  
Life @ 5°C: 6 months  
Life @ 22°C: 2 days  
Life @ 35°C: 0.5 days  
Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 132 cm  
Shimadzu Viscosity, 175°C, 1000 psi: 55 poise  
Ram Follower Gel Time, 175°C, 1000 psi: 18 sec  
Ash Content: 88.6 %  
Hydrolyzable Halides: <1 ppm  
Alpha Particle Count: <0.002 counts/cm<sup>2</sup>/hr  
Moisture Absorption, 85°C/85%RH, 168 hrs: 0.275%  
Cull Hot Hardness, Shore D: 75  
All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C  
Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 9 cm<sup>-6</sup>/cm/°C  
Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 35 cm<sup>-6</sup>/cm/°C

## Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Molding Temperature: 165 to 185°C

Molding Pressure: 1000 psi

In Mold Cure Time: 50 to 100 sec

Post Mold Cure Time, 175°C: 0 to 2 hr

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

